

深圳市力合微电子股份有限公司

关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 4.60 亿元。
- 本事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2021 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度不超过人民币 46,000 万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、承兑、保函、贸易融资、信用证、承诺等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，拟授权公司总经理在上述综合授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关业务合同及其它相关文件。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2021年6月9日